

tSML - Blindplatte Snap-In für Modul 19"/0.5HE



tSML - tde Semi Modular Link

tSML ist ein modular aufgebautes Verkabelungssystem, das aus zwei Kernkomponenten besteht: Modul und Trunkkabel. Es handelt sich hierbei um vorkonfektionierte getestete Systemkomponenten, die vor Ort insbesondere in Rechenzentren eine Plug & Play Installation innerhalb kürzester Zeit ermöglichen. Die LWL und TP Module können mit ihren Abmessungen von 19 " 0,5HE zusammen innerhalb einer Höheneinheit mit sehr hoher Portdichte kombiniert eingesetzt werden. Bis zu 96x LWL Duplex bzw. 48x RJ45 Ports sind so auf 1HE möglich. Das Herz des Systems sind die rückseitigen MPO/ MTP[®] und Telco Steckverbinder, über die mindestens 6 Ports mit 10GbE bzw. GbE Performance auf einmal verbunden werden können.

Zur Abdeckung nicht benötigter Slots. Es können beim tSML - Modul 19 "/0.5HE 4x Blindplatten eingesetzt werden.



tde[®] trans data elektronik GmbH

Hausanschrift:

Lingener Str. 2
D-49626 Bippen/Ohrte
Tel.: +49 5435 9511 0
Fax.: +49 5435 9511 32

Vertriebsbüro:

Prinz-Friedrich-Karl-Str. 46
D-44135 Dortmund
Tel.: +49 231 8805 61 13
Fax.: +49 231 8805 61 15

info@tde.de | www.tde.de

tSML - Blindplatte Snap-In für Modul 19"/0.5HE

Technische Daten

| | |
|-------------|--|
| Material | Edelstahl |
| Befestigung | Snap-In frontseitig im tSML - Modul |
| | QS-Managementsystem nach ISO 9001, ISO 14001 und TL 9000 |

Artikelvarianten & Zubehör

| Art.-Nr. | Beschreibung |
|---------------------|---|
| TSML-M-19/0.5HE-KB | tSML - Modul 19"/0.5HE gerade unbestückt ohne Abdeckung f. 4x LWL Teilfrontplatten o. 4x RJ45 DC 6er |
| TSML-M-BLIND | tSML - Blindplatte Snap-In für Modul 19"/0.5HE |
| TSML-MS-19/0.5HE-KB | tSML - Modul 19"/0.5HE gewinkelt unbestückt o. Abdeckung f. 4x LWL Teilfrontplatten o. 4x RJ45 DC 6er |